

トランスクリプト

司会：冒頭のあいさつ

それでは、お時間となりましたので、東京エレクトロン株式会社 2024年3月期 第1四半期の決算説明会を開催いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。わたくし、司会進行を務めます、IR室の八田です。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の出席者の紹介をいたします。代表取締役社長・CEO 河合 利樹でございます。

河合：河合でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

続きまして、常務執行役員ファイナンス担当 川本 弘でございます。

川本：川本でございます。本日はよろしくお願いいたします。

プレゼンテーションに先立ち、私から、本日の会の流れについてご説明させていただきます。これより、川本、河合のプレゼンテーションをお聞きいただきます。その後 18:30 まで、質疑応答のお時間を設け、皆さまからのご質問をお受けしたいと思っております。本説明会は、Webex を 2 回線使い、日英の同時通訳でおこなっております。先日、メールでご案内させていただいたとおり、音声のみお聞きになりたい方は、電話でもご参加いただけますが、ご質問されたい方は、PC もしくはモバイル端末のアプリをお使いください。また、本説明会は機関投資家さま・アナリストさま向けの説明会となっております。大変申し訳ございませんが、回答は、従来どおり機関投資家・アナリストの方々のご質問に限らせていただきます。本説明会につきましては、後日、日英の音声配信を HP 上に掲載いたしますので、こちらも併せてご利用ください。

それでは、はじめに、常務執行役員 川本より、「連結決算の概要」についてご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

本決算 連結決算の概要

川本 弘（常務執行役員 ファイナンスユニット GM）

改めまして、川本でございます。わたくしの方から第1四半期連結決算の概要からご説明申し上げます。

損益状況（四半期）：スライド 4

まずはじめに、四半期ごとの損益状況についてご説明いたします。青色の枠が直近の第1四半期の結果でございます。第1四半期の売上高でございますが、お客さまの設備投資減少の影響を受け、前四半期比 29.8%減少の 3,917 億円となりました。売上総利益は売上の減少に伴い、前四半期比 35.5%減少の 1,623 億円。営業利益は、46.0%減少の 824 億円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 45.8%減少の 643 億円となりました。下段の研究開発費は、436 億円と、成長に向けた研究開発投資を継続しており、前年同期比からは増加いたしました。設備投資額でございますが、393 億円と、前四半期から 49.2%増加しております。増加の要因は、将来の事業拡大に備えた宮城地区での

トランスクリプト

研究開発棟建設や評価装置取得などによるものでございます。

損益状況（四半期）：スライド5

こちらは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列でグラフで示したものになります。ご確認くださいいただければと思います。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1）：スライド6

こちらは、地域別の第1四半期の売上でございます。今期から単一セグメント開示となっており、全社での地域別売上高構成比のグラフとなっております。中国向け売上高について、成熟世代向け設備投資が活発におこなわれた結果、ご覧のとおり、39.3%と構成比が上昇しております。

SPE 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）：スライド7

こちらは、「SPE 新規装置のアプリケーション別売上構成比」になります。一番右が第1四半期でございますが、下からロジックが70%、不揮発性メモリ14%、DRAM16%となりました。直近の四半期四半期と比較しますと、ロジックと不揮発性メモリの構成比は低下、DRAMの構成比は上昇いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）：スライド8

こちらは、「フィールドソリューション売上高」になります。第1四半期は、1,002億円となりました。お客様の設備投資額の減少に伴い、改造案件については減少いたしました。その関係で、前四半期比で減少しておりますが、パーツ・サービスの売上につきましては、堅調に推移いたしました。

貸借対照表（四半期）：スライド9

続きまして、「貸借対照表」に移ります。資産の合計は、2兆1,790億円となりました。現金同等物は、4,010億円。この第1四半期は配当の支払い、納税、自己株式の買い付けなどございましたので、前四半期から720億円減少しております。売上債権及び契約資産は、回収が進み、960億円減少の3,688億円。棚卸資産は、今後の出荷に備えた調達などにより、643億円増加の7,165億円。その他の流動資産は、消費税の還付により、857億円減少の650億円となっております。続きまして、右側の負債・純資産でございます。負債は、720億円減少の6,399億円。こちらは先ほどの納税の実施、6月の賞与引当金、賞与の支給などによる減少が要因となっております。純資産は、1兆5,390億円となりました。配当の支払い、前回の決算で発表させていただきました自己株式の買い付けの開始などより、前期末から604億円減少しております。ご参考までに、自己資本比率は69.9%となっております。

キャッシュ・フロー（四半期）：スライド10

続きまして、「キャッシュ・フロー」につきまして簡単にご説明させていただきます。営業キャッシュ・

トランスクリプト

フローは、1,257億円の獲得となりました。設備投資など、投資キャッシュ・フローは、368億円を支出いたしました。財務キャッシュ・フローにつきましては、配当の支払い、自己株式の買い付けなどにより、1,641億円の支出となっております。折れ線グラフでございますが、フリーキャッシュ・フローは、888億円となっております。

自己株式の取得状況：スライド 11

最後に、最新の「自己株式の取得状況」をお伝えいたします。直近7月31日現在でございますが、6月から7月にかけて取得した株式の総数は、306万9,200株、株式の取得額の総額は、およそ609億円となりました。下に記載のとおり、1,200億円を上限でございますので、約半分を買い付けたこととなります。引き続き12月末を期限として自己株式の取得を継続いたします。以上、第1四半期「連結決算の概要」をわたくしからご報告いたしました。

司会：次のプレゼンテーションの紹介

それでは、続きまして、CEO 河合より、「事業環境および業績予想」について、ご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

事業環境および業績予想

河合 利樹（代表取締役社長・CEO）

皆さん、こんにちは。本日はご参加いただきましてありがとうございます。改めまして、河合でございます。私の方から「事業環境および業績予想」についてご報告申し上げます。

事業環境（2023年8月時点でのWFE市場の見方）：スライド 13

まず、足元の「事業環境」について、ご説明いたします。本年のWFE市場の見通しにつきましては、70Bから75Bドル程度と、規模としては、5月の決算説明会から変更はございません。ただ、内訳につきましては、若干の変更があり、先端ロジック/ファウンドリで投資延期が見られる一方、成熟世代における中国顧客の投資が加速しています。マクロ経済の動向により、回復のタイミングは多少前後する可能性があります。WFE市場は、2024年、25年の2年間の合計で、200Bドル程度に回復・成長すると見ております。その牽引役としましては、ご覧の図のように、年率8%で拡大するサーバーが代表例として挙げられますが、ここでは、最先端のCPU、DRAM、NANDのほか、生成AI向けGPU、HBMなどの事業機会があります。加えて、コロナ終息後に調整されていたPC、スマートフォンの需要回復も期待できます。なお、EV向けなどのパワーデバイスや、デジタル社会を支える多様な半導体、いわゆる当社が申しあげているMAGIC市場においては、引き続き堅調な成長が見込まれます。

FY2024 Q1 事業進捗：スライド 14

トランスクリプト

次に、「FY2024 第1四半期の事業進捗」についてご説明いたします。業績については、先ほど川本から説明しましたとおり、売上・利益ともに順調に進捗しました。また、中期経営計画の達成に向けた、重要な開発テーマやプロダクトにおいて、着実な進捗が見られました。特に、戦略工程である HARC エッチングにおいて、NAND チャンネルホール向けの、革新的な技術開発に成功いたしました。将来の売上・利益に貢献する重要なアイテムであり、お客さまからの評価状況も大変良好です。また、先端パッケージングにおける貼り合わせ装置については、生成 AI 用途の HBM 向け量産受注に加えて、3D NAND や先端ロジック向けにも開発・評価が進んでおります。

FY2024 業績予想：スライド 15、16

次に、「FY2024 の業績予想」について説明いたします。こちら、業績予想に関しましては、前回5月の発表から変更はございません。前述のとおり、CY2023 の WFE 市場は、前年比 25~30%のマイナス成長となる見込みです。当社業績も、その影響を受けますが、来年、再来年の WFE 市場の成長、および、それに伴う当社業績の回復を見越し、今年度も研究開発の手を緩めず、過去最高の 2,000 億円を投資する予定です。

FY2024 SPE 新規装置売上予想：スライド 17

こちらは、「FY2024 の SPE 新規装置の売上予想」です。ご覧のとおり、上期は 5,800 億円、下期は 6,900 億円の見込みです。今上期の売上予想を四半期ごとに分解すると、右の図のようになります。お客さまの投資の入り繰りはありましたが、ロジック・メモリの構成比に大きな変更はございません。

FY2024 研究開発費・設備投資計画：スライド 18

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。こちら、変更はございません。FY2024 は、いずれも過去最高となる見通しで、先ほど触れましたとおり、研究開発費は、2,000 億円、設備投資は、1,240 億円を計画しています。また、減価償却費につきましては、570 億円を見込んでおります。なお、先月、山梨県の新開発棟を計画どおり竣工しました。成膜装置、ガスケミカルエッチング装置、パターニング技術、および、プロセスインテグレーションの開発を目的としております。引き続き、拡大する市場と、多様化する最新の技術ニーズに応えるため、積極的な研究開発と設備投資をおこなってまいります。

FY2024 配当予想：スライド 19

次に、「配当予想」についてです。こちら、変更はございません。今期の業績予想と、配当性向 50%に基づき、1株当たりの配当は、通期で 320 円を予定しております。

総還元額：スライド 20

こちらは、「総還元額の推移」になります。先ほど、川本からも説明いたしましたとおり、7月31日現

トランスクリプト

在、306万9,200株、約609億円分の自己株式を取得しております。計画どおりに自己株式が取得できた場合の今期の総還元額は、配当性向50%に基づく配当と合わせ、2,703億円となる見込みです。今後、株主価値の向上に努めてまいります。私からのご報告は以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。